



Marking - engraving laser system.
Laser Beschriftungs- und Graviersystem

BIG SMARK

VERSATILITY

Increased functionality of the laser source allows for **engraving marking** and **microcutting** to meet the highest technical standards available.

WIDE WORK CHAMBER

The **500 mm x 500 mm** work chamber (maximum piece height 530mm with F100 focal lens) is easy to access thanks to the door that opens on three sides.

FLEXIBLE SYSTEM

It can be integrated with all Sisma accessories as well as the **Coaxial Vision System** and the **Pattern Matching** software.

ADVANCED SOFTWARE

Entirely developed by Sisma, the **integrated software** is the ideal solution for file management and parameters defining, even for **complex jobs**

VIELSEITIGKEIT

Das multifunktionelle System kann zum **Gravieren**, **Markieren** und **Feinschneiden** eingesetzt werden und erfüllt die höchsten verfügbaren technischen Standards.

GROSSER ARBEITSRAUM

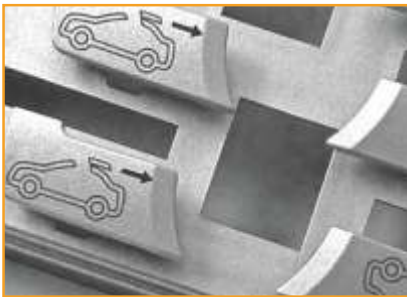
Die **500 x 500 mm** Arbeitskammer (max. Teilehöhe 530mm mit F100 Brennweite) ist dank der auf drei Seiten öffnenden Tür sehr gut zugänglich.

FLEXIBLES SYSTEM

Sämtliches Sisma Zubehör kann integriert werden, z.B. das Vision System mit autom. Teileerkennung.

FORTSCHRITTLICHE SOFTWARE

Die von Sisma eigens entwickelte Softwarepaket managed das gesamte System von der Projekterstellung bis zur Ausführung.



Technical Data - Données technique

	200F	200F EP	300F	400F	500F	700F	1000F	GREEN	UV
Laser source - Laser Strahlquelle	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Nd:YV04	Nd:YV04
Wavelength - Wellenlänge	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	532 nm	532 nm	355 nm
Average laser power - Laser Nennleistung	20 W	20 W	30 W	40 W	50 W	70 W	100 W	10 W	3 W
Pulse frequency - Pulsfrequenz	1-500 kHz	1-1000 kHz	1-500 kHz	1-1000 kHz	1-500 kHz	1-500 kHz	CW-1000 kHz	1-300 kHz	1-300 kHz
Pulse duration - Pulsbreite	260/40 ns	3-500 ns	260/40 ns	10-240 ns	250/40 ns	260/40 ns	17/500 ns	30 ns	35 ns
Max pulse energy - Max. Pulsenergie	1/0,21 mJ	0,03-1 mJ	1/0,21 mJ	0,16 - 1,33 mJ	1/0,21 mJ	1/0,21 mJ	0,1/1 mJ	0,25 mJ	0,075 mJ
Beam quality - Strahlqualität	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 3,5 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,6 M ²	≤ 1,2 M ²	≤ 1,3 M ²
Laser spot diameter - Laser Fokusdurchmesser	20 µm	20 µm	20 µm	40 µm	20 µm	20 µm	20 µm	12 µm	7 µm
Max marking speed - Max. Schreibgeschwindigkeit	2000 mm/s					5000 mm/s		2000 mm/s	
Focal lenses - F Theta Objektive	F100, F160 (standard), F254, F330							F100, F160	F160
4 th axes - 4. Achse	Optional								
Guide laser - Ziel-Laser	Class 2M Red Laser Diode; WL=650 nm; 2 mW								
Working temperature - Arbeitstemperatur	10°C to 35°C - non condensing								
Cooling system - Kühlsystem	Forced-air cooling - aktive Luftkühlung						Wasser	aktive Luftkühlung	
Working chamber - Arbeitsraum	500 x 500 x 380 mm								
Power supply - Anschlusswerte	230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW								
Dimensions (WxDxH) - Abmessungen (LxBxH)*	650 x 1040 x 1760 mm								
Weight - Gewicht	640 kg								

Hans Wittich GmbH - Kirchstrasse 17 - 8274 Gottlieben - Schweiz - Tel 071 666 80 30 - info@wittich.ch - www.wittich.ch